

## 國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號  
聯絡人：程稚茵  
電話：02-2737-7232  
傳真：02-2737-7619  
電子信箱：parker@nsc.gov.tw

受文者：行政院農業委員會

發文日期：中華民國112年3月7日  
發文字號：科會產字第1120013762號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：請至本會附件下載區 [https://odattach.nsc.gov.tw/most\\_sodatt/](https://odattach.nsc.gov.tw/most_sodatt/) 下載附件，驗證碼：G79SQ7

主旨：「2023台灣創新技術博覽會」之TIE Award徵件，自即日起受理，請查照並協助推廣報名。

說明：

- 一、旨揭博覽會將於112年10月12日(四)至10月14日(六)於台北世貿一館展出，以成為國際研發交易樞紐平台為定位，由11大部會展示逾1600件國內前瞻技術，並邀請海外機構參展，共同展現我國創新技術能量。為強化臺灣全球科研平台角色，自2022年起辦理國家級獎項TIE Award，吸引全球科技新創人才來參展，並促進後續落地。
- 二、請協助於所轄網站刊登活動資訊，相關宣傳文件詳附件(下載連結：<https://reurl.cc/9VXapx>)，徵件說明如下：
  - (一)報名資格：
    - 1、全球科技新創、法人及學研機構。
    - 2、今年因應產業需求擴大合作領域就「半導體」及「淨零排放」雙主題，以「應用創新性」、「價值創造性」及「在地連結性」為評分標準，選出共12隊獲獎團隊。
    - 3、獲獎團隊須配合實體展出並與台灣企業鏈結，本會將於名單確定後協助來台事宜。
  - (二)報名方式：團隊須於台灣時間112年5月31日前，至TIE Award 徵件網站完成線上報名([www.futuretech.org.tw](http://www.futuretech.org.tw))。
  - (三)獲選獎勵：
    - 1、本獎項獎金逾16萬美金(新台幣486萬元)，就2項主題分

別選出第一名3萬美元；第二名2萬美元；第三名1萬美元及特別獎3名獎金7,000美元。

- 2、獲獎者可享有TIE展會國內外的行銷資源，包括實體及線上展示空間、系列宣傳，及臺灣科技新創基地（TTA）進駐空間、臺灣半導體研究中心（TSRI）特定平台服務等資源。

三、本案聯絡窗口：高秋凌小姐，Taipei Computer Association，  
Tel: 866-2-2577-4249#844，Email: 電子信箱 [kinki@mail.tca.org.tw](mailto:kinki@mail.tca.org.tw)

正本：外交部、教育部、衛生福利部、數位發展部、國防部、勞動部、國家發展委員會、行政院國家發展基金管理會、行政院農業委員會、行政院環境保護署、經濟部智慧財產局、經濟部工業局、經濟部能源局、經濟部中小企業處、經濟部技術處、本會科教國合處、駐外單位（共18單位）

副本：本會各處室及所屬機關（共8單位）、本會各所屬機關（共3單位）、中央研究院、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家同步輻射研究中心、國家災害防救科技中心、台北市電腦商業同業公會、財團法人工業技術研究院(均含附件)

2023-03-08  
交09:換43章

主任委員吳政忠